

低出力レーザー加工機活用セミナーのご案内

大分県産業科学技術センターでは低出力レーザー加工機を導入しました。本装置は80WCO₂レーザーを搭載し、DXFやSVG等のCADデータを用いて、各種軟質素材[※]の切断加工や素材表面への刻印等を行うことができます。

本セミナーでは、「この装置を使ってどのような素材を加工できるのか」、「どのようなデータを準備すれば加工できるのか」、等について説明すると共に、ご希望があれば、参加者持ち込み素材の切断テストを実施いたします。

参加を希望される場合には、下記参加申込書にご記入の上、FAX またはEメールで担当宛にお申し込み下さい。また、持ち込み素材の切断テストを希望される参加者は、種類、サイズを事前にお伝え下さい。可否を回答します。



低出力レーザー加工機は、公益財団法人JKA（競輪）の補助事業により導入しました。

各種軟質素材の切断加工や素材表面への刻印加工が可能です。

ご希望により、持ち込み素材の切断テストが可能です。

1. 主催 大分県産業科学技術センター
2. 開催日時 **令和2年6月19日(金) 13:30~15:00**
3. 開催場所 **大分県産業科学技術センター材料開発棟 G107**
(大分市高江西1丁目4361-10)
4. 内容 (1) 機器の概要 (2) サンプル素材の切断等による実演
5. 申込期限 令和2年6月17日(水)
6. 参加費用 無料
7. 問い合わせ 大分県産業科学技術センター
製品開発支援担当 (担当) 佐藤幸志郎
TEL: 097-596-7100 メール: satokou@oita-ri.jp

※ 主な軟質素材対応	刻印	切断	(備考)
合板・シナベニヤ	○	○ (~12mm)	
透明アクリル板	○	○ (~15mm)	
塩ビ	×	×	塩素ガス発生のため加工不可
ABS樹脂	○	○ (~5mm)	
天然・合成レザー	○	○	塩ビ系は加工不可 合成品は要素材確認
段ボール	○	○	
ガラス	○	×	

メーカー	(株)smartDIYs(スマートディーアイワイズ)
機種名	FABOOL Laser DS
加工サイズ	W1050 × D630 mm
レーザー方式	CO ₂ レーザー 80W
対応加工方式	ベクター加工、ラスター加工
対応CAD・画像ファイル	svg, dxf, png, jpg, bmp, gif, tif

レーザー加工機のメリットとは？

- 紙、皮革の抜き加工で必要となる抜き型や、合板等のNCルーター加工で必要となる工具経路設定作業が不要となります。CADデータを作成すれば、即加工可能です。
- 従来の加工方法では固定できず廃棄・焼却していた小サイズの端材なども無駄なく加工できるため、廃棄物削減にも貢献できる加工技術となっています。

低出力レーザー加工機活用セミナー 参加申込書

申込先：大分県産業科学技術センター 製品開発支援担当 行 (FAX) 097-596-7110 (Eメール) satokou@oita-ri.jp

企業名：			電話 [※] ：
参加者氏名	部署名	役職	備考(持ち込み素材があれば種類・サイズを記入)

※開催に関するお知らせを行う場合がありますので、電話番号は必ずご記入下さい。